

# Produktdatenblatt

DIN 41612 Federleiste gerade Bauform C/3,  
Art. Nr. 304-78116-04

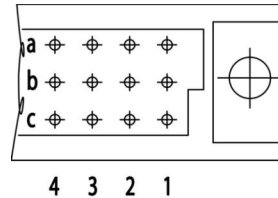
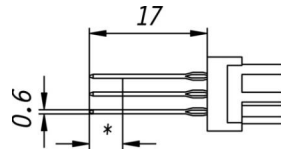
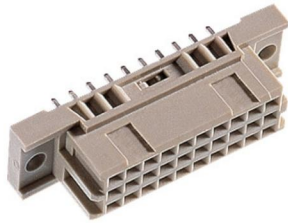


Abbildung ähnlich



Parallel



Rechtwinklig



Einpresstechnik



Rugged

- Anschlusslänge 17 mm
- mit Steckzone in Gütestufe 2
- Polzahl 30
- Einpresstechnik
- Gütestufe 2



» zum Produkt auf [www.ept.de](http://www.ept.de)



» zur Produktgruppe DIN 41612

# Produktdatenblatt

DIN 41612 Federleiste gerade Bauform C/3,  
Art. Nr. 304-78116-04



## Technische Daten

### Grundlagen

Spezifikation	IEC 60603-2 (DIN 41612)
Gütestufe	2
Anzahl Kontakte	30
Anschlusstechnik	Einpresstechnik
Anschlusslänge	17 mm
Leiterplattenabstand	16.85 mm
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C

### Material

Isolierkörper	PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0
CTI Wert <i>IEC 60112</i>	200
Kontaktmaterial	Kupferlegierung

### Mechanisch

Rastermaß	2.54 mm
Steckkraft	< 28 N
Ziehkraft pro Kontakt	> 0.15 N
Lebensdauer	400 Steckzyklen

### Elektrisch

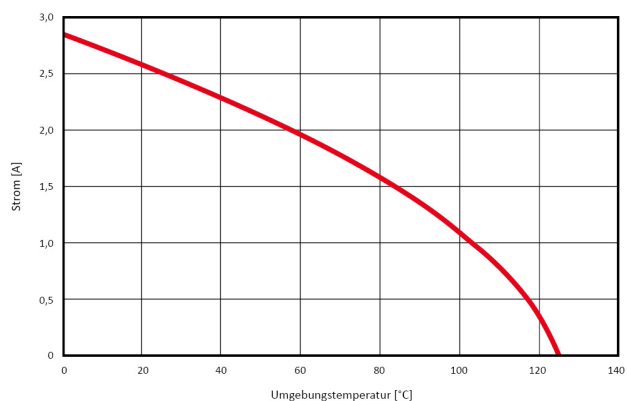
Betriebsstrom	2.6 A
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Luft- und Kriechstrecke	≥ 1.2 mm
Isolationswiderstand	> 10 <sup>6</sup> MΩ
Prüfspannung	1000 V

### Zulassungen / Konformität

UL file	E130314
Umwelt	RoHS konform

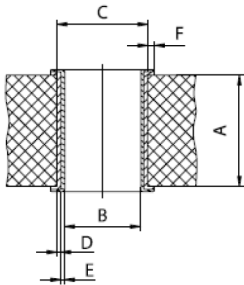
### Derating Diagramm

Stromtragfähigkeit DIN C (96-polig)  
max. 2.6A bei 20°C



### Lochspezifikation

Schichtaufbau nach IEC 60352-5



Material	chem. Sn Leiterplatten
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 1.0 mm</b>
<b>A Leiterplattendicke</b>	min 1.44 mm
<b>B Endloch</b>	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
<b>C Grundbohrung</b>	1.15 ±0.025 mm
<b>D Cu Schicht</b>	min. 25 µm
<b>E Oberfläche</b>	chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm
<b>F Restring</b>	min. 0.1 mm

Material	Ni, Au Leiterplatten
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 1.0 mm</b>
<b>A Leiterplattendicke</b>	min 1.44 mm
<b>B Endloch</b>	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
<b>C Grundbohrung</b>	1.15 ±0.025 mm
<b>D Cu Schicht</b>	min. 25 µm
<b>E Oberfläche</b>	Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni
<b>F Restring</b>	min. 0.1 mm

Material	rein Cu Leiterplatten
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 1.0 mm</b>
<b>A Leiterplattendicke</b>	min 1.44 mm
<b>B Endloch</b>	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
<b>C Grundbohrung</b>	1.15 ±0.025 mm
<b>D Cu Schicht</b>	min. 25 µm
<b>E Oberfläche</b>	OSP, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm
<b>F Restring</b>	min. 0.1 mm

Material	HAL Sn Leiterplatten
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 1.0 mm</b>
<b>A Leiterplattendicke</b>	min 1.44 mm
<b>B Endloch</b>	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
<b>C Grundbohrung</b>	1.15 ±0.025 mm
<b>D Cu Schicht</b>	min. 25 µm
<b>E Oberfläche</b>	HAL Sn, 5 - 15 µm
<b>F Restring</b>	min. 0.1 mm

# Produktdatenblatt

DIN 41612 Federleiste gerade Bauform C/3,  
Art. Nr. 304-78116-04

---



## Modifikationen

Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch

- ohne Befestigungsflansch
- Sonderlänge für Anschlüsse
- Gütestufen I + III oder kundenspezifisch
- Sonderbestückung

## Zubehör

- » DIN 41612 Kodierung Bauform B und C  
Artikelnummer 104-19003

## Zeichnungen

Die Kundenzeichnung zu diesem Produkt erhalten Sie auf Anfrage unter [sales@ept.de](mailto:sales@ept.de)